【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和5年6月19日(2023.6.19)

【国際公開番号】WO2022/085319
【出願番号】特願2022-557264(P2022-557264)
【国際特許分類】
H01L 23/12(2006.01)
G01R 33/02(2006.01)
G01R 33/06(2006.01)
【FI】
H01L 23/12 501S
G01R 33/02 U
G01R 33/06

【手続補正書】
【提出日】令和5年3月30日(2023.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
接続端子が設けられた第１表面を有し、該第１表面に沿って磁気検出素子が配置された磁気センサチップと、
前記接続端子と電気的に接続され、前記第１表面に沿いつつ前記第１表面と直交する方向から見て前記磁気センサチップの縁より外側まで延在している接続配線層と、
前記第１表面と直交する方向から見て前記磁気センサチップの縁より外側の位置にて前記接続配線層と電気的に接続され、前記磁気センサチップに間隔をあけて前記磁気センサチップに沿って延在している柱状電極と、
前記接続配線層の磁気センサチップ側の面とは反対側の面と接しつつ、前記第１表面を覆う絶縁層と、
前記柱状電極の接続配線層側とは反対側の端面と電気的に接続された接続電極とを備え、
前記絶縁層および前記接続配線層は、プリント配線板から形成されている、磁気センサパッケージ。
【請求項２】
前記絶縁層は、厚みが１０μｍ以下の薄膜で構成されている、請求項１に記載の磁気センサパッケージ。
【請求項３】
前記柱状電極の前記端面および前記接続電極の各々と電気的に接続され、前記柱状電極の前記端面に沿う方向に延在している延長配線層をさらに備える、請求項１または請求項２に記載の磁気センサパッケージ。
【請求項４】
前記磁気センサチップの少なくとも周面を覆うモールド樹脂部をさらに備え、
前記磁気センサチップの前記第１表面とは反対側の第２表面は、研削面であり、前記モールド樹脂部から露出している、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の磁気センサパッケージ。